

winbond

華邦電子

2024年華邦電子高雄廠

實習生招募(學年制)

想探索半導體產業的奧秘嗎?
加入華邦高雄廠學年制實習計畫
開啟職場學習之旅，跨出對半導體認識的第一步！
與華邦工作夥伴攜手合作共同成長



實習資訊

1. 實習職務：半導體設備、製程(具POWER BI專長佳)、製程整合實習工程師
2. 實習期間：學年制 (2024/07-2025/06)
3. 實習班別：日班
4. 實習薪資：NTD39,000/月
5. 報名方式：請參考下方各職務於華邦招募官網之職缺說明並投遞履歷

歡迎電機、電子、機械、資工、資管等理工相關科系的同學投遞履歷

- 1 設備實習工程師：<https://careers.winbond.com/job-invite/10783/>
- 2 製程實習工程師：<https://careers.winbond.com/job-invite/10787/>
- 3 製程整合實習工程師：<https://careers.winbond.com/job-invite/10784/>



- 竹北大樓
新竹縣竹北市文興路二段 539 號
- 中科廠
台中市大雅區中部科學園區科雅一路 8 號
- 高雄廠
高雄市路竹區奇科高雄園區路科五路 35 號



成為邦粉，關注投微最新消息